

证券代码：688173

证券简称：希荻微

记录编号：2025-IR-006

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	【华安证券股份有限公司】： 汤宏伟 【深圳市泰聚私募证券基金管理有限公司】： 徐景榆 【深圳财沣投资有限公司】： 吕喆 【深圳坤西基金管理有限公司】： 冷波 【佛山市深联投资有限公司】： 阚文东 【广州市龙智投资管理有限公司】： 杨玉玲 【广州春晖私募基金管理有限公司】： 冯伟贤
时间	2025 年 6 月 6 日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	【主讲人】： 唐娅 财务总监、董事会秘书 吴昊晟 董事会秘书助理
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：介绍公司基本情况 公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业

	务为包括电源管理芯片和信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，现有产品布局覆盖 DC/DC 芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片等，具备高效率、高精度、高可靠性的良好性能。 第二部分：问答环节 Q： 请问模拟芯片市场国产替代的空间？ A： 研究机构 Mordor Intelligence 表示，2024 年，全球模拟芯片市场将达到 912.6 亿美元。根据 Frost & Sullivan 统计，中国模拟芯片市场规模在全球范围占比达 50%以上，为全球最主要的模拟芯片消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。信达证券研究报告显示，受益于国家政策支持 and 国内厂商的技术突破，2024 年模拟芯片自给率预计增长至 16%，但仍然有较大的提升空间。 Q： 请问公司在电源管理芯片领域的优势？ A： （1）在消费电子领域，公司多款消费级 DC/DC 芯片较早进入了 Qualcomm 平台参考设计，可以为智能手机、可穿戴等移动终端电子设备处理器、存储器、OTG 功能、WiFi 模组等核心单元供电，已广泛应用于三星、小米、vivo、传音、联想等品牌客户的消费电子设备中。2024 年，公司围绕硅负极电池前沿应用场景率先推出了定制化 DC/DC 芯片产品，可以为 AI 手机和 AI 眼镜等智能电子设备长续航加持。此外，公司电荷泵充电芯片产品在充电效率、充电功率等方面具有相较海外厂商竞品更好的表现，以及更好的电路保护功能和更小的芯片面积，相关产品已成功导入三星、OPPO、传音、荣耀、龙旗、华勤等全球知名品牌客户的供
--	--

	应链体系。（2）在汽车电子领域，公司车规级 DC/DC 芯片进入了 Qualcomm 智能座舱汽车平台参考设计，已实现了向 Joynext、Yura Tech 等全球知名的汽车前装厂商出货，并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外，公司车规级 LDO 稳压芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货。 Q：请问公司诚芯微收购项目进展如何？ A：公司于 2025 年 5 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。公司及相关中介正在就审核问询函所提问题进行认真核查和分析，将在规定期限内尽快提交问询回复给上海证券交易所，感谢您对公司的关注与支持。 Q：请问公司后续人才招聘策略如何？ A：截至 2024 年末，公司研发人员的数量占比超过 60%，彰显了公司对技术创新与产品研发的高度重视。展望 2025 年，公司将秉持稳健审慎的人才招聘策略，确保人力资源配置与公司战略目标同频共振。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 6 日